



Sentry-X2は、NVIDIA® Jetson AGX Orin Industrialモジュールを搭載したMIL規格の堅牢なAIシステムです。

ミッションクリティカルなアプリケーション向けに設計されたSentry-X2は、タクティカルエッジにおけるコンピューティングのためのMIL規格の堅牢なAIシステムです。

4x 3G-SDI/HD-SDI/SDI入力と2x 3G-SDI/HD-SDI/SDI出力、さらに10GbE, 2.5GbE, 1GbE, 2x USB 3.2 など幅広いI/Oが搭載されています。



Elite Partner



Sentry-X2は、MIL-STD規格に準拠した衝撃・振動試験を実施し、IP67規格のD38999コネクタを使用してデータの完全性を確保しており、軍事、航空宇宙、重工業アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計されています。

FEATURES

- ✓ 4x 3G-SDI/HD-SDI/SDI 入力
2x 3G-SDI/HD-SDI/SDI 出力
- ✓ 3x Ethernet Ports:
10GbE, 2.5GbE, 1GbE
- ✓ IP67, MIL-STD-810H テスト
- ✓ 最大 4TB NVMe ストレージ

SPECIFICATIONS

Compatibility	Pre-integrated with NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial	AI Performance	248 TOPS
GPU	2048-core NVIDIA® Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores	CPU	12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3
Memory	64GB 256-bit LPDDR5 (+ ECC) 204.8GB/s	Dimensions	200mm x 180mm x 125mm (7.87" x 7.09" x 4.92")
Video Output	1x DisplayPort 1.4 Output 4K @ 60HZ	Networking	1x 10GBASE-T Ethernet (10GbE) 1x 2.5GBASE-T Ethernet (2.5GbE) 1x 1000BASE-T Ethernet (1GbE)
SDI Camera	4x 3G-SDI/HD-SDI/SDI Inputs 2x 3G-SDI/HD-SDI/SDI Outputs	USB	2x USB 3.2 Ports (10Gbps Capable)
Wireless / Misc Expansion	1x 4TB NVMe WiFi/BT (optional)	Trusted Platform Module (TPM)	SLB9670 TPM2.0 Chipset Hardware TPM Implementation
Input Power/Misc Power Details	MIL-STD-704F Input Power +28V Nominal Operating Voltage (+16V to +50V Range as specified by MIL-STD-704F) EMI/EMC as per MIL-STD-461F/G	GPIO / Serial Interfaces	8x 3.3V GPIO (2x PWM capable) 1x 3.3V, 1A Source pin 2x UART (RS232/422/485 configurable) 1x 3.3V I2C 1x 3.3V SPI 2x 3.3V UART 2x CAN
Operating Temperature	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)	Weight	2.5 kg
MIL Specifications	Environmental: MIL-STD-810H, DO-160H EMC/EMI: MIL-STD-461G, MIL-HDBK-704F, MIL-HDBK-831	Optional MIL-STD 1553B	1x MIL-STD 1553
Warranty and Support	1 Year Warranty and Free Support		

